

ARRANGEMENT METHOD OF MINUTE SUBSTANCES AND FORMING METHOD OF CONNECTION STRUCTURE EMPLOYING THE ARRANGEMENT METHOD

Publication number: JP10084178 (A)

Publication date: 1998-03-31

Inventor(s): TEZUKA SHINJI; IWABUCHI TOSHIAKI

Applicant(s): RICOH KK

Classification:

- International: H01L21/60; H05K3/34; H05K3/10; H05K3/32; H01L21/02; H05K3/34; H05K3/10; H05K3/32; (IPC1-7): H05K3/34; H01L21/60

- European:

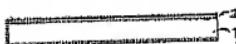
Application number: JP19960260278 19960909

Priority number(s): JP19960260278 19960909

Abstract of JP 10084178 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an arrangement method which enables fine arrangement of minute substances easily and securely, and provide the forming method of a connection structure which enables the highly reliable connection of fine pattern pitch electrodes with conductive substances which are arranged by the arrangement method. SOLUTION: An ultraviolet radiation 4 is applied to an ultraviolet curing adhesive layer 2 formed on a substrate 1 by using a mask 3 to cure the adhesive layer 2. Then, minute substances 5 are brought into contact with the whole surface of the adhesive layer 2 and bonded to the parts of the adhesive layer 2 to which the ultraviolet radiation 4 is not applied. The unnecessary minute substances on the substrate 1 are removed. Or, a transparent substrate 1 may be employed and, after the minute substances 5 are arranged on the adhesive layer 2, the ultraviolet radiation 4 may be applied to the rear side of the substrate 1. Or, a patterned photoresist layer may be used as the adhesive layer 2. Further, by utilizing the above mentioned arrangement method, conductive particles are arranged on electrodes of a wiring board only and the other electrodes are connected to the electrodes of the board with the conductive particles therebetween to obtain a highly reliable connection structure.

(A)



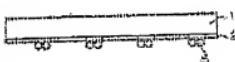
(B)



(C)



(D)



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-84178

(43) 公開日 平成10年(1998)3月31日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
H 05 K 3/34	5 0 1		H 05 K 3/34	5 0 1 E
H 01 L 21/60	3 1 1		H 01 L 21/60	3 1 1 Q

審査請求 未請求 請求項の数10 FD (全 7 頁)

(21) 出願番号	特願平8-260278	(71) 出願人	000008747 株式会社リコー 東京都大田区中馬込1丁目3番6号
(22) 出願日	平成8年(1996)9月9日	(72) 発明者	手冢 伸治 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

(54) 【発明の名称】 微小物体の配列方法及び該配列方法を用いた接続構造の形成方法

(57) 【要約】

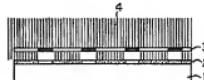
【課題】 微小物体の微細な配列を容易かつ確実に行なうことのできる配列方法と、この配列方法を利用して配列させた導電体により、微細な電極パターンピッチでも信頼性の高い接続を行うことのできる接続構造の形成方法を提供する。

【解決手段】 基体1に設けた紫外線硬化型粘着層2にマスク3を用いて紫外線4を照射し、粘着層2を硬化させる工程と、粘着層2の全面に微小物体5を接触させ、紫外線の非照射部分に粘着させる工程と、基体1上の不要の微小物体を除去する工程を有するようにする。また基体1を透明なものにし、粘着層2に微小物体5を配した後に、基体1の背面側から紫外線を照射してもよく、粘着層2にバターン化したフォトレジストを用いてもよい。また、上記の配列方法を利用して、図示しない配線基板の電極上の導電粒子を配置し、この導電粒子を介して他の電極と接続させることにより、高い信頼性を持つ接続構造を得るようにする。

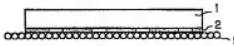
(A)



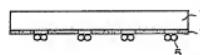
(B)



(C)



(D)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基体上に設けた紫外線硬化型樹脂からなる粘着層の一部に紫外線を照射し、該照射部分の前記粘着層を硬化させて粘着力を低下させる工程と、前記粘着層の全面に微小物体を接触させ、前記紫外線の非照射部分に前記微小物体を粘着させて配列する工程と、前記照射部分に付着した不要の微小物体を除去する工程を有することを特徴とする微小物体の配列方法。

【請求項2】 透明な基体上に設けた紫外線硬化型樹脂からなる粘着層の全面に微小物体を粘着させる工程と、前記粘着層の一部に前記基体の背面側から前記粘着層の一部に紫外線を照射し、該照射部分の前記粘着層を硬化させて粘着力を低下させる工程と、前記照射部分の前記微小物体を除去して前記紫外線の非照射部分に前記微小物体を配列する工程を有することを特徴とする微小物体の配列方法。

【請求項3】 基体上に設けたフォトレジスト層をフォトリソグラフィーによりパターン化する工程と、前記パターン化されて前記基体上に残留した前記フォトレジスト層を粘着層として、該粘着層に微小物体を粘着させて配列する工程を有することを特徴とする微小物体の配列方法。

【請求項4】 透明な第1の基体上に設けた紫外線硬化型樹脂からなる第1の粘着層の全面に微小物体を粘着させる工程と、前記第1の粘着層より低粘着力の第2の粘着層を設けた第2の基体と前記微小物体を粘着させた前記第1の基体とを重ね合わせる工程と、重ね合わせた前記第1の基体の背面側から前記第1の粘着層の一部に紫外線を照射し、該照射部分の第1の粘着層を硬化させて粘着力を低下させる工程と、前記第2の基体から前記第1の基体を剥離して前記第1の基体上の前記照射部分の微小物体を前記第2の基体上に転写して配列させる工程を有することを特徴とする微小物体の配列方法。

【請求項5】 第1の配線基板上の電極端子と第2の配線基板上の電極端子とを導電体を介して電気的に接続するようにした接続構造の形成方法において、前記第1の配線基板と前記第2の配線基板は、前記各配線基板間に充填された第1の接着剤によって固定され、前記導電体は前記電気的に接続する領域にのみ存在するようにし、前記各電極端子の少なくとも一方に設けられた第2の接着剤により固定されるようにすることを特徴とする接続構造の形成方法。

【請求項6】 請求項5記載の接続構造の形成方法において用いる電極端子に導電体が配された前記第1又は第2いずれかの配線基板を得る工程として、請求項1～3いずれか1記載の微小物体の配列方法により、前記微小物体に該当する導電体を第1の粘着層を設けた第1の基体上に配列する工程と、前記第1の粘着層よりも高粘着力の第2の粘着層が設けられた第2の基体と前記導電体が配列した前記第1の基体とを重ね合わせ、前記第2

粘着層の粘着力により前記導電体を前記第2の基体に転写する工程と、表面に接着剤が設けられた電極端子を備える前記配線基板と前記導電体が転写された前記第2の基体とを重ね合わせ、前記接着剤の接着力により前記導電体を前記電極端子上に転写して配列させる工程を有するようにすることを特徴とする接続構造の形成方法。

【請求項7】 請求項5記載の接続構造の形成方法において用いる電極端子に導電体が配された前記第1又は第2いずれかの配線基板を得る工程として、請求項4記載の微小物体の配列方法により、前記微小物体に該当する導電体を前記第2の基体上に配列する工程と、表面に接着剤が設けられた電極端子を備える前記第1の配線基板と前記導電体が配列した前記第2の基体とを重ね合わせ、前記接着剤の接着力により前記導電体を前記電極端子上に転写して配列させる工程を有するようにすることを特徴とする接続構造の形成方法。

【請求項8】 請求項6または7記載の接続構造の形成方法において、前記第2の基体が透明であり、前記第2の粘着層が紫外線硬化型樹脂からなり、前記転写時に紫外線を照射して前記第2の粘着層の粘着力を低下させ、前記転写を容易に行うようにすることを特徴とする接続構造の形成方法。

【請求項9】 請求項5記載の接続構造の形成方法において用いる電極端子に導電体が配された前記第1又は第2いずれかの配線基板を得る工程として、請求項1または2記載の微小物体の配列方法により、透明な基体上に前記微小物体に該当する導電体を配列する工程と、表面に接着剤が設けられた電極端子を備える前記配線基板と前記導電体が配列した前記基体とを重ね合わせ、前記基体の背面側から紫外線を照射して前記粘着層を硬化させて粘着力を低下させ、前記導電体を前記電極端子上に転写して配列させる工程を有するようにすることを特徴とする接続構造の形成方法。

【請求項10】 請求項8または9記載の接続構造の形成方法において、前記接着剤を紫外線硬化型接着剤とし、前記転写時に照射する紫外線により前記導電粒子と前記接着剤を強固に接着させるようにすることを特徴とする接続構造の形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 この発明は、微小物体を目的の位置に配列させる方法に関し、より詳細には、2枚の電気回路基板上の対向する電極端子位置に導電体を配し、両者の電気的接続を行う方法に関するものである。微小物体を配列させる方法については、例えば、配列するものとしてトナーを用いることにより、画像形成装置への応用ができるものである。

【0002】

【従来の技術】 図6は、従来技術による電極パターンの接続構造を示す断面図で、図中、1 1は第1の配線基

板、1 2 は第2の配線基板、1 3、1 4 は電極、1 5 は導電粒子、1 6、1 7 は接着剤である。図6に示すように、従来、微細な電極パターン同士を接合する際には、接触加圧部のみに導電性を示す異方性導電材料が用いられている。例えば特公平3-40899号公報に開示されている回路の接続構造体は、導電性粒子を絶縁性接着剤中に混合させたものを基板間に挿入し、両基板の電極で導電性粒子を挟み、加圧された部分で電気的な接続を行なうようにしたものである。このような接続方式では、接続ピッチが狭くなると、基板間に存在し本来接続に寄与しない導電粒子の横方向の接触が起きやすくなり、短絡が生じてしまうという問題点があった。

【0003】そこで、特開平4-292803号公報に開示された異方導電性フィルムでは、接続材料として絶縁性被覆を持ち、導電粒子を内包した樹脂を分散配合したフィルムを用いている。この接続材料は、未加圧状態では導電性を示さないために、接続ピッチが微細化して接続材料同士が接触することにならぬ短絡するがない。しかしながら、この構造においては、接続材料を形成する工程が複雑であり、その製造コストも高くなるという問題点が生じる。

【0004】また、この他先行技術の例として、所定の位置に貫通孔を有するマスクを表面粘性を有する部材上に密着させ、導電粒子を前記貫通孔内に入れた後にマスクを分離して導電粒子を配列し、その後に電極端子上に転写するようにしたものがあり、これにより、導電粒子は電極上にのみ配列されるので、横方向の短絡は起きない。しかしながら、導電粒子として樹脂粒子表面に金属膜を形成したものを用いているため、マスクの貫通孔内に粒子を入れる工程中に貫通孔端面や粒子移動手段端面等が導電粒子に接触することにより、前記金属膜の破壊もしくは剥離が生じ、接続不良が発生することがある。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上述のような実情に鑑みてなされたもので、微小物体の微細な配列を容易かつ確実に行なうことのできる配列方法と、この配列方法を利用して配列させた導電体により、微細な接続ピッチでも安価に歩留りよく、かつ信頼性の高い接続を行うことのできる電極パターンの接続構造の形成方法を提供することをその解決すべき課題とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、基体上に設けた紫外線硬化型樹脂からなる粘着層の一部に紫外線を照射し、該照射部分の前記粘着層を硬化させて粘着力を低下させる工程と、前記粘着層の全面に微小物体を接触させ、前記紫外線の非照射部分に前記微小物体を粘着させて配列する工程と、前記照射部分に付した不要の微小物体を除去する工程を有することを特徴としたものである。

【0007】請求項2の発明は、透明な基体上に設けた

紫外線硬化型樹脂からなる粘着層の全面に微小物体を粘着させる工程と、前記粘着層の一部に前記基体の背面側から前記粘着層の一部に紫外線を照射し、該照射部分の前記粘着層を硬化させて粘着力を低下させる工程と、前記照射部分の前記微小物体を除去して前記紫外線の非照射部分に前記微小物体を配列する工程を有することを特徴としたものである。

【0008】請求項3の発明は、基体上に設けたフォトレジスト層をフォトリソグラフィーによりパターン化する工程と、前記パターン化されて前記基体上に残留した前記フォトレジスト層を粘着層として、該粘着層に微小物体を粘着させて配列する工程を有することを特徴としたものである。

【0009】請求項4の発明は、透明な第1の基体上に設けた紫外線硬化型樹脂からなる第1の粘着層の全面に微小物体を粘着させる工程と、前記第1の粘着層より低粘着力の第2の粘着層を設けた第2の基体と前記微小物体を粘着させた前記第1の基体とを重ね合わせる工程と、重ね合わせた前記第1の基体の背面側から前記第1の粘着層の一部に紫外線を照射し、該照射部分の第1の粘着層を硬化させて粘着力を低下させる工程と、前記第2の基体から前記第1の基体を剥離して前記第1の基体上の前記照射部分の微小物体を前記第2の基体上に転写して配列させる工程を有することを特徴としたものである。

【0010】請求項5の発明は、第1の配線基板上の電極端子と第2の配線基板上の電極端子とを導電体を介して電気的に接続するようにした接続構造の形成方法において、前記第1の配線基板と前記第2の配線基板は、前記各配線基板間に充填された第1の接着剤によって固定され、前記導電体は前記電気的に接続する領域にのみ存在させるようにし、前記各電極端子の少なくとも一方に設けられた第2の接着剤により固定されるようにすることを特徴としたものである。

【0011】請求項6の発明は、請求項5記載の接続構造の形成方法において用いる電極端子に導電体が配された前記第1又は第2いずれかの配線基板を得る工程として、請求項1～3いずれか1記載の微小物体の配列方法により、前記微小物体に該当する導電体を第1の粘着層を設けた第1の基体上に配列する工程と、前記第1の粘着層よりも高粘着力の第2の粘着層が設けられた第2の基体と前記導電体が配列した前記第1の基体とを重ね合わせ、前記第2の粘着層の粘着力により前記導電体を前記第2の基体に転写する工程と、表面上に接着剤が設けられた電極端子を備える前記配線基板と前記導電体が転写された前記第2の基体とを重ね合わせ、前記接着剤の接着力により前記導電体を前記電極端子上に転写して配列させる工程を有することを特徴としたものである。

【0012】請求項7の発明は、請求項5記載の接続構

造の形成方法において用いる電極端子に導電体が配された前記第1又は第2いずれかの配線基板を得る工程として、請求項4記載の微小物体の配列方法により、前記微小物体に該当する導電体を前記第2の基体上に配列する工程と、表面に接着剤が設けられた電極端子を備える前記第1の配線基板と前記導電体が配列した前記第2の基体とを重ね合わせ、前記接着剤の接着力により前記導電体を前記電極端子上に転写して配列させる工程を有することを特徴としたものである。

【0013】請求項6または7記載の接続構造の形成方法において、前記第2の基体が透明であり、前記第2の粘着層が紫外線硬化型樹脂からなり、前記転写時に紫外線を照射して前記第2の粘着層の接着力を低下させ、前記転写を容易に行なうようにすることを特徴としたものである。

【0014】請求項9の発明は、請求項5記載の接続構造の形成方法において用いる電極端子に導電体が配された前記第1又は第2いずれかの配線基板を得る工程として、請求項1または2記載の微小物体の配列方法により、透明な基体上に前記微小物体に該当する導電体を配列する工程と、表面に接着剤が設けられた電極端子を備える前記配線基板と前記導電体が配列した前記基体とを重ね合わせ、前記基体の背面側から紫外線を照射して前記粘着層を硬化させて接着力を低下させ、前記導電体を前記電極端子上に転写して配列させる工程を有することを特徴としたものである。

【0015】請求項10の発明は、請求項8または9記載の接続構造の形成方法において、前記接着剤を紫外線硬化型接着剤とし、前記転写時に照射する紫外線により前記導電粒子と前記接着剤を強固に接着させるようすることを特徴としたものである。

【0016】

【発明の実施の形態】以下に、本発明が適用される微小物体の配列方法及び接続構造の形成方法の実施形態を添付された図面を参照して具体的に説明する。なお、実施形態を説明するための図全において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。図1は、請求項1の発明を説明するための図で、微小物体の配列分法の一実施形態の断面図を工程に従って示すものである。図中、1は基体、2は紫外線硬化型樹脂層(粘着層)、3はマスク、4は紫外線、5は微小物体である。図1(A)に示すごとく、紫外線硬化型樹脂層2を有する粘着部材(例えば、古河電気工業株式会社製ダイシングテープ(UC1827)を用意し、これに図1(B)に示すごとく、紫外線透過部と遮断部を設けたマスク3を介して紫外線4を規定量以上照射する。これにより、紫外線を照射された部分の紫外線硬化型樹脂層2は硬化して接着性を失う。この状態で、図1(C)に示すごとく、紫外線硬化型樹脂層2側全面に微小物体5を配置し、軽く圧力を加えるか、もしくは微小物体5がな

められている部分に前記粘着部材を押し当てる。これにより、紫外線非照射部に、紫外線硬化型樹脂層2が本来の有する接着力により微小物体5が固定される。紫外線照射部にも一部微小物体は付着することがあるが、粘着面に対して軽くエアブローもしくは振動を与えることにより除去することができる。従って、これらの工程を経た後には、図1(D)に示すごとく、前記粘着部材の紫外線非照射部のみに微小物体5を固定することができる。ここで、紫外線硬化型樹脂層2は、接着力があるためにマスク3を離して照射するのが通常であり、半導体プロセスで用いるステッパーを用いることが好ましい。

【0017】また、前述したダイシングテープは、通常基材表面に塗工形成した紫外線硬化型樹脂層上にセパレーターを貼り合わせた3層構造になっている。従って、セパレーターを剥離することなく、セパレーター上にマスクを密着させた状態で紫外線を照射する方法を採用することにより、マスクと紫外線硬化型樹脂層との間隔がほぼ一定となるので、特別な装置を必要とせず、一定のパターン形成を行うことができる。また、このようなダイシングテープの基材自体も透明であるために、粘着面の背面から同様に照射することによっても同様な効果を得ることができる。

【0018】図2は、請求項2記載の発明を説明するための図で、微小物体の配列方法の他の実施形態の断面図を工程に従って示すものである。ここでは、図1に示した実施形態と同様の粘着部材を用い、該粘着部材が有する紫外線硬化型樹脂層2の全面に微小物体5を配置するか、もしくは一面に微小物体5を敷きつめて、ここに該部材を押し当てる。これにより、図2(B)に示すごとく、紫外線硬化型樹脂層2の全面に微小物体5が付着した状態となる。ついで、図2(C)に示すごとく、この粘着部の背面よりマスク3を介して紫外線4を規定量照射する。これにより、紫外線は透明な基体1を透過して、紫外線硬化型樹脂層2に達し、照射部の該樹脂層は硬化して、接着力を失うことになる。この状態で、紫外線硬化型樹脂層2の表面に対してエアブローもしくは振動を与えることにより、照射領域に付着した微小物体5を除去することができる。従って、これらの工程を経た後には、図2(D)に示すごとく、粘着部材上の紫外線非照射部のみに微小物体5を固定し配列することができる。

【0019】図3は、請求項3の説明をするための図で、微小物体の配列方法の更に他の実施形態の断面図を工程に従って示すものである。図中、1'は基板、6はレジスト層である。まず、図3(A)に示すごとく、ガラス等の接着力を持たない基板1'の上にフォトレジスト層6を形成する。このときのフォトレジストとしては、エマルジョン系のものが望ましく、例えば、東京応化株式会社製BMRレジストがあげられる。次に、図3(B)及び図3(C)に示すごとく、このフェトレジス

ト層6をフォトリソグラフィープロセスにより微小物体を配列させたい位置のみにレジスト領域を残すようにパターン化する。図3 (D) に示すごとく、こうして形成した基板1'の全面に微小物体5を配置するか、もしくは一面に微小物体5が敷きつめられた部分へ基板1'を押し当てる。同種のフォトレジストは多少の粘着力を有するために、図3 (E) に示すごとく、フォトレジスト部のみに微小物体を配列保持することができる。

【0020】図4は、請求項4を説明するための図で、微小物体の配列方法の更に他の実施形態の断面図を工程に従って示すものである。図中、7は第2の粘着部材である。ここでは、図4 (A) に示すごとく、図1に示した実施形態と同様の粘着部材を用意し、図4 (B) に示すごとく、紫外線硬化型樹脂層2の全面に微小物体を配置するか、もしくは一面に微小物体が敷き詰められた部分へ前記粘着部材を押し当てる。これにより、紫外線硬化型樹脂層2の全面に微小物体が付着した状態となる。この粘着部材は、前述したように基体1が透明であり、この状態で、図4 (C) に示すごとく、前記粘着部材よりも弱い粘着力を有する第2の粘着部材7を押し当てる。この粘着部材7に適した材料として、具体的にはシリコンゴムがあげられる。ここで、紫外線硬化型樹脂層2の全面に、微小物体5を配列させる部分のみ基体1の背面から紫外線4を規定量照射する。これにより、照射部の紫外線硬化型樹脂層2は硬化して粘着力を失う。その後に、図4 (D) に示すごとく、両者を分離すると、紫外線非照射部の微小物体5は紫外線照射部の微小物体5は、第2の粘着部材7側へ転写され、結果として第2の粘着部材6の上へ微小物体を配列することができる。

【0021】配列工程の1サイクルは、ここで終了するが、第2の粘着部材7上に配列した微小物体5を他の場所に移動させ、図4 (E) ないし図4 (G) に示すごとく、再び基体1に押し当て、ここで、マスク3の位置をずらして紫外線4の照射を行うことにより、同様の配列を第2の粘着部材7上に形成させることができる。このような方法により、微小物体5の利用効率を高めることができる。

【0022】図5は、請求項5を説明するための電極パターンの接続構造を示す断面図で、図中、図6と同じ作用する部分には、図6と同じ符号が付してある。第1の配線基板1 1及び第2の配線基板1 2は、各基板面に対して凸形状の互いに接続されるべき電極1 3、1 4を持つ。これらの電極表面の少なくとも一方には、接着剤層1 6が設けられていて、この接着剤層1 6により両電極に挟まれる形で導電性粒子1 5が固定されている。これら基板間のその他の隙間部分には、絶縁性の接着剤1 7が充填されており、これにより両基板が接合されている。このとき、導電性粒子1 5は接続されるべき電極1 3、1 4の上のみ存在するような構造となっている。

このような構造では、電極間隔を狭めても横方向の電気的接觸は起きにくい。

【0023】請求項1から4記載の配列方法を用いることにより配列部材(粘着層を設けた基材)上に配列された導電粒子(微小物体)を、該配列部材の粘着力より大きな粘着力を持つ転写部材(第2の粘着層を設けた基材)と重ねた後に分離することにより、両者の粘着力の差によって導電粒子は転写部材側へ転写する。そしてこの導電粒子が配列した転写部材を基板の電極上に導電性粒子がくるように位置決めした後に、該転写部材と該基板とを重ね合わせる。その状態で電極表面に形成されている接着剤の硬化を行なうなどして転写部材上の導電粒子を電極上に固定する。この後、基板と転写部材を分離することにより電極上に導電粒子を配列することができる。このとき、請求項8に示すように転写部材として前述したようなダイシングテープを用い、電極上に重ねた後に粘着面の背面側から紫外線を照射することにより、電極上へ容易に転写することができる。

【0024】上記配列部材としてダイシングテープを用いてその上に導電粒子を配列させた後、直接基板の電極上に重ね合わせた後に裏面から紫外線を照射することで、配列部材全面の樹脂は硬化するために、電極上へ導電粒子が転写される。この方法により、転写部材及び転写工程を省くことができる(請求項9)。

【0025】電極上に紫外線照射を行なって導電粒子を転写する際に、電極上に紫外線硬化型の接着剤を塗布しておく。これにより、転写時に紫外線照射を行うことにより電極上の接着剤が硬化し、導電粒子を確実に固定することができる(請求項10)。

【0026】

【発明の効果】

請求項1、2の効果：紫外線を照射することにより粘着層の粘着力を制御して、微小物体を配する方法であるので、紫外線の照射パターンで微小物体の配列を決定できるので、容易に、かつ確実に微小物体を配列することができる。

【0027】請求項3の効果：フォトリソグラフィーにより粒子を配列させる領域を形成するので、より微細な配列を実現することができる。

【0028】請求項4の効果：全面に微小物体が配された基材上の紫外線照射部のみの微小物体を転写・配列に利用するようにしているので、紫外線照射時に基材をずらしながら転写を行なうことにより、同一の基材で複数回の転写・配列が可能であり、粒子の利用効率を高めることができる。

【0029】請求項1ないし4の効果：微小物体の配列を基材上面の面内で一括して形成することができるので、配列の形状、配列させる物体の数に関わらず、同一の工程で配列を得ることができる。

【0030】請求項5の効果：接続すべき電極上にのみ

導電体が存在するようにしているので、接続ピッチが微細になっても短絡する事なく、高密度の接続を実現できる。

【0031】請求項6の効果：紫外線照射工程を経て第1の基体上に配列した導電粒子を第2の基体上に転写したち電極上に再度転写するようしているため、第1の基体が1枚で複数回の転写を行うことができ、製造コストを低減することができる。

【0032】請求項7の効果：請求項4記載の配列方法を利用しているので、全面に付着させた粒子を複数回の配列形成に利用でき、粒子の利用効率が高く、実装コストを低減することができる。

【0033】請求項8の効果：電極上に導電粒子を転写する際に、導電粒子が配列されている基体に紫外線照射を行なうことにより、導電粒子の保持力が弱まるので、より確実に電極上に導電粒子を配列することができる。

【0034】請求項9の効果：導電粒子が配列せている基体を直接基板上に重ねて導電粒子を電極上に転写するため、転写するための第2の基体が省略でき、またこれを使用した転写工程の削減が行えるので、製造コストを低減することができる。

【0035】請求項10の効果：電極上に塗布する接着剤が紫外線硬化型であるので、導電粒子の転写時に紫外線照射を行って接着剤を硬化させることにより、導電粒子が電極上に確実に固定され、信頼性の高い接続構造を得ることができる。

得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 請求項1の発明を説明するための図で、微小物体の配列分法の一実施形態の断面図を工程に従って示すものである。

【図2】 請求項2記載の発明を説明をするための図で、微小物体の配列方法の他の実施形態の断面図を工程に従って示すものである。

【図3】 請求項3の説明をするための図で、微小物体の配列方法の更に他の実施形態の断面図を工程に従って示すものである。

【図4】 請求項4を説明するための図で、微小物体の配列方法の更に他の実施形態の断面図を工程に従って示すものである。

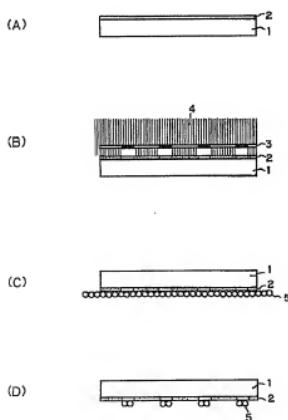
【図5】 請求項5を説明するための電極パターンの接続構造を示す断面図である。

【図6】 従来技術による電極パターンの接続構造を示す断面図である。

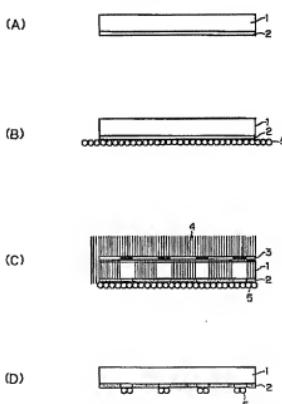
【符号の説明】

1…基体、1'…基板、2…紫外線硬化型樹脂層（粘着層）、3…マスク、4…紫外線、5…微小物体、6…レジスト層、7…第2の粘着部材、1 1…第1の配線基板、1 2…第2の配線基板、1 3, 1 4…電極、1 5…導電粒子、1 6, 1 7…接着剤。

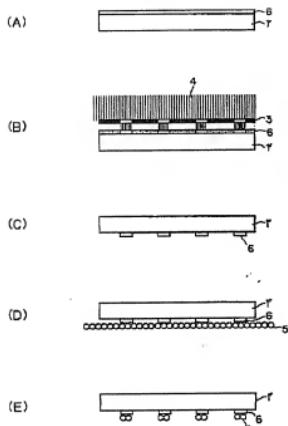
【図1】



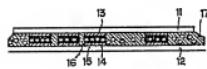
【図2】



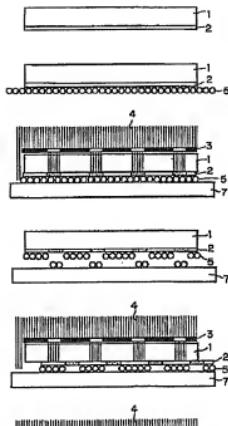
【図3】



【図6】



【図4】



【図5】

